

第81回

应用物理学会秋季学術講演会

The 81st JSAP Autumn Meeting 2020

会期 2020年9月8日(火)～11日(金)

場所 オンライン開催予定

現地開催の場合：同志社大学 今出川校地(京都府京都市)

登壇申込締切：2020年6月23日(火)17:00(厳守)

URL：<https://meeting.jsap.or.jp/entry>

●事前参加申込締切：2020年8月19日(水)

ご注意

- 登壇申込締切以後の登録内容の修正、予稿の差し替え、申込の取消はいたしかねます。
- 大会HP掲載の「应用物理学会学術講演会講演規程」を必ずご一読のうえ、お申し込みください。
- ご提出いただいた予稿および当日の発表スライドの著作権は应用物理学会に帰属します。
- 登壇申込が完了した時点で参加費（債務）が発生します。やむを得ず当日欠席される場合や代理の方が講演される場合も、参加費のお支払いが必要です。
- ご希望の発表分科(各分科・シンポジウム・コードシェアセッション)は、お申込み時の希望に添えない場合があります。希望と異なる場合も登壇者の方への事前の連絡はいたしませんのでご了承ください。

一般講演で登壇するための3つのステップ

1. 入会登録

※※非会員のみ※※

一般会員

入会金 10,000円
年会費 10,000円

大学生・大学院生

入会金 3,000円
年会費 3,000円

※初年度は年会費無料

登壇するには、入会金（または年会費）と参加費のお支払いが必要です。

2. 登壇申込

**6月23日(火)
17:00締切**

締切以降の取消、差し替え、修正は一切受け付けておりませんのでご注意ください。

登壇申込が完了した時点で、登壇者の方には参加費（債務）が発生します。事前予約または当日受付で参加費のお支払いをお願いいたします。

3. 参加申込

**8月19日(水)
締切**

事前予約

正会員	12,000円
学生	3,000円
シニア会員*	4,000円
協定学会**会員	12,000円
非会員***	23,000円

当日受付

正会員	18,000円
学生	5,000円
シニア会員*	7,000円
協定学会**会員	18,000円
非会員***	30,000円

※オンライン開催が確定した場合は当日価格を値下げする可能性あり（検討中）

(*)常勤として勤務に就かれていない60歳以上の会員。一般会員からの種別変更が必要です。

(**)協定学会：APS(American Physical Society), CSOE(Chinese Society for Optical Engineering), EOS(European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), OSJ(日本光学会), OSK(Optical Society of Korea), PESJ(日本物理教育学会), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SPIE(International Society for Optical Engineering), TPS(Taiwan Photonics Society)

(***)ご所属先が賛助会員であっても、参加者本人が個人会員でない場合は非会員扱いとなります。

以下の常設の大分類、中分類および合同セッション、シンポジウムで一般講演を募集します。

※お申込みいただいた発表希望に添えない場合があります。

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
フォーカストセッション 「AIエレクトロニクス」 Focused Session "AI Electronics"	(キーワード) ニューロモルフィック、脳型コンピュータ、シナプス、STDP、ニューラル ネット、神経回路、リザーバコンピューティング	(Keywords) newromorphic, brain computer, synapse, STDP, neural network, neural circuit, reservoir computing
1 応用物理学一般 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology	1.1 応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and General Physics
	1.2 教育	Education
	1.3 新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering
	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	Energy conversion, storage, resources and environment
	1.5 計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and Metrology
	1.6 超音波	Ultrasonics
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals
	2.2 検出器開発	Detection systems
	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology
	2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析・微量元素分析	Accelerator mass spectrometry, Accelerator beam Analysis
	2.5 医用応用	Medical application
	2.6 放射線誘起蛍光体	Radiation-induced phosphors
3 光・フォトニクス Optics and Photonics	3.1 光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics
	3.2 材料・機器光学	Equipment optics and materials
	3.3 情報フォトニクス・画像工学	Information photonics and image engineering
	3.4 生体・医用光学	Biomedical optics
	3.5 レーザー装置・材料	Laser system and materials
	3.6 超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers
	3.7 レーザープロセッシング	Laser processing
	3.8 光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor
	3.9 テラヘルツ全般	Terahertz technologies
	3.10 光量子物理・技術	Optical quantum physics and technologies
	3.11 フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena
	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics
	3.13 半導体光デバイス	Semiconductor optical devices
	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fibers
3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	Silicon photonics and integrated photonics	
4 JSAP-OSA Joint Symposia すべてEnglish Session	4.1 Plasmonics and Nanophotonics	Plasmonics and Nanophotonics
	4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics	Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics
	4.3 Lasers and laser materials processing	Lasers and laser materials processing
	4.4 Information Photonics	Information Photonics
	4.5 Nanocarbon and 2D Materials	Nanocarbon and 2D Materials
	4.6 Terahertz Photonics	Terahertz Photonics
	4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics	Quantum Optics and Nonlinear Optics
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces	6.1 強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films
	6.2 カーボン系薄膜	Carbon-based thin films
	6.3 酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics
	6.4 薄膜新材料	Thin films and New materials
	6.5 表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum
	6.6 プロブ顕微鏡	Probe Microscopy
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.1 X線技術	X-ray technologies
	7.2 電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams
	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication
	7.4 量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam
	7.5 イオンビーム一般	Ion beams
	7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics	8.1 プラズマ生成・診断	Plasma production and diagnostics
	8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	Plasma deposition of thin film, plasma etching and surface treatment
	8.3 プラズマナノテクノロジー	Plasma nanotechnology
	8.4 プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences
	8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications
	8.6 Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session
	8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	Plasma Electronics Invited Talk
	8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演	Plasma Electronics Award Speech
9 応用物性 Applied Materials Science	9.1 誘電材料・誘電体	Dielectrics, ferroelectrics
	9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	Nanoparticles, Nanowires and Nanosheets
	9.3 ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics
	9.4 熱電変換	Thermoelectric conversion
	9.5 新機能材料・新物性	New functional materials and new phenomena
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetics	10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	Emerging materials in spintronics and magnetics (including fabrication and characterization methodologies)
	10.2 スピン基盤技術・萌芽のデバイス技術	Fundamental and exploratory device technologies for spin
	10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	Spin devices, magnetic memories and storages
	10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics
	10.5 磁場応用	Application of magnetic field

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
11 超伝導 Superconductivity	11.1 基礎物性	Fundamental properties
	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth
	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications
	11.4 アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies
	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication process, digital applications
12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics	12.1 作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls
	12.2 評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics
	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	Functional Materials and Novel Devices
	12.4 有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors
	12.5 有機太陽電池	Organic solar cells
	12.6 ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology
	12.7 医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips
13 半導体 Semiconductors	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
	13.2 探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
	13.3 絶縁膜技術	Insulator technology
	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	Si processing /Si based thin film / MEMS / Equipment technology
	13.5 デバイス/配線/集積化技術	Semiconductor devices/ Interconnect/ Integration technologies
	13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	Nanostructures, quantum phenomena, and nano quantum devices
	13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology
	13.8 光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices
	13.9 化合物太陽電池	Compound solar cells
15 結晶工学 Crystal Engineering	15.1 バルク結晶成長	Bulk crystal growth
	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds
	15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	III-V-group epitaxial crystals, Fundamentals of epitaxy
	15.4 III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals
	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys
	15.6 IV族系化合物 (SiC)	Group IV Compound Semiconductors (SiC)
	15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal characterization, impurities and crystal defects
	16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
16.2 エナジーハーベスティング		Energy Harvesting
16.3 シリコン系太陽電池		Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	Carbon nanotubes & other nanocarbon materials
	17.2 グラフェン	Graphene
	17.3 層状物質	Layered materials
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"	(キーワード) 薄膜成長, 物性評価, 透明導電膜, 電子デバイス, 光デバイス, 新機能材料・新技術開発	(Keywords) thin film growth, characterization of physical properties, transparent conductive oxide film, electronic devices, optical devices, novel functional materials & development of novel technologies
合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 Joint Session M "Phonon Engineering"	(キーワード) 材料開発・材料物性, 計測技術, 理論・シミュレーション, 熱伝導・フォノン輸送, ナノスケール・低次元系, バンドエンジニアリング, コヒーレント制御, フォノンポラリトン, マグノン, 熱マネジメント・熱設計技術, デバイス応用, 熱電変換, 蓄熱, 断熱, マイクロ/ナノメカニクス, 放熱, 熱変換, ナノ構造・デバイス作製技術	(Keywords) material development and material properties, measurement methods, theory and simulation, thermal conduction and phonon transport, nanoscale and low dimensional system, band engineering, coherent control, phonon polariton, magnon, thermal management and design technology, device application, thermoelectrics, thermal storage, thermal insulation, micro/nanomechanics, heat dissipation, thermal conversion, nano-structure/device fabrication technology
合同セッションN 「インフォーマティクス応用」 Joint Session N "Informatincs"	(キーワード) マテリアルズインフォーマティクス, 計測インフォーマティクス, データ科学, データマイニング, 機械学習, スパースモデリング, 深層学習, ベイズ最適化, データ同化	(Keywords) materials informatics, measurement informatics, data science, data mining, machine learning, sparse modeling, deep learning, Bayes optimization, data assimilation

シンポジウム一覧は以下をご参照ください。

<https://meeting.jsap.or.jp/symposium>